

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2026-006

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年全年主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	679,323.36	592,631.53	14.63
营业利润	91,209.13	85,230.15	7.02
利润总额	91,168.18	85,181.45	7.03
归属于母公司所有者的净利润	87,123.89	82,192.14	6.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	75,858.09	74,627.78	1.65
基本每股收益（元）	2.08	1.97	5.58
加权平均净资产收益率	12.63%	13.87%	减少1.24个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	864,683.13	736,602.99	17.39
归属于母公司的所有者权益	734,434.26	639,422.54	14.86
股本（万股）	42,116.56	41,873.48	0.58
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	17.44	15.27	14.21

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025 年，公司近年来重点投入的新产品批量上市，快速打开市场局面，公司多年来在全球化市场的持续耕耘逐步进入收获期，经营业绩稳步增长，经营质量持续提升。2025 年全年，公司实现营业收入 67.93 亿元，同比增加 8.67 亿元；归属于母公司所有者的净利润 8.71 亿元，同比增加 0.49 亿元；全年芯片销量超 1.74 亿颗，同比增加超 0.31 亿颗。2025 年度营业收入、归属于母公司所有者的净利润以及芯片销量均创历史新高。

2025 年，公司因股权激励确认的股份支付费用为 0.47 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响为 0.51 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响，2025 年归属于母公司所有者的净利润为 9.22 亿元。

在 2024 年“运营效率提升年”的基础上，2025 年公司持续推进运营效率提升行动项，2025 年公司综合毛利率逐季提升，分别为 36.23%、37.29%、37.74%、40.46%，2025 年全年综合毛利率 37.97%，同比 2024 年综合毛利率（36.55%）绝对值提升 1.42 个百分点。2026 年公司还将持续推进运营效率提升，经营质量还将继续改善。

2025 年是端侧智能技术快速发展年，公司不断推出契合市场需求的芯片产品，当前公司各产品线已有超过 20 款芯片搭载自研端侧智能算力单元。2025 年，搭载自研端侧智能算力单元的芯片出货量已超 2,000 万颗，同比增长近 160%。与此同时，公司充分发挥平台型 SoC 技术优势，联合全球智能领域头部客户和新兴客户，持续推动芯片在创新硬件形态和应用场景上的突破，2025 年已有多款适配最新端侧大模型或新应用场景的新产品上市。

2025 年是公司新产品大规模商用年，多个重点投入的战略性产品实现规模化商用，这些产品不仅在当期贡献业绩，也为未来多年公司业绩持续增长奠定了坚实基础。

1. 6nm 芯片 2025 年实现销量近 900 万颗，已通过大规模商用验证。公司已

将 6nm 制程技术进一步应用于即将推出的更高算力、更广应用范围的通用端侧平台产品；2026 年，预计 6nm 芯片出货量有望突破 3,000 万颗。

2. Wi-Fi 6 芯片 2025 年实现销量超 700 万颗，在 W 系列中占比已超过 37%（去年同期近 11%）；2026 年，预计 Wi-Fi 6 芯片出货量有望突破 1,000 万颗。
3. 智能视觉芯片 2025 年实现销量超 400 万颗，同比增长超 80%。
4. 2026 年，公司还将有一批新产品陆续上市，包括更高算力的通用端侧平台芯片、T 系列高端芯片、Wi-Fi 路由芯片、Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片，高算力智能视觉芯片以及 Monitor 系列的首款芯片等，这些产品将助力公司在相关市场领域实现更好的业绩表现。

公司多年来全球化多渠道市场拓展与多产品线运营的成果和优势，正逐步显现。在 To B 端，公司已与全球各主要经济区域的近 270 家运营商建立合作关系，在 To C 端，公司 2025 年与多个全球著名消费电子客户推出多款新产品。在原有 S 系列、T 系列、A 系列 SoC 芯片的基础上，2025 年无线连接芯片 W 系列全年销量近 2,000 万颗，智能视觉芯片 C 系列全年销量超 400 万颗，均已成为公司主力产品线。

2025 年下半年，面对全球存储市场的剧烈变化，公司凭借多元化渠道布局与丰富的产品品类，结合自身业务需求与市场预判，对存储芯片实施了前瞻性、合理有序的备货安排，有效保障了客户对公司 SoC 产品的需求，抵消了来自需求端的不利影响。截止 2025 年第四季度，SoC 的主力产品营收已恢复到正常水平，2025 年第四季度，公司营收同比增长约 34%，其中 S 系列营收同比增长近 60%，T 系列营收同比增长逾 50%，W 系列营收同比增长逾 30%。

面对存储市场的持续变化，公司将继续合理安排存储芯片备货与供应，保障客户需求，并上调相关 SoC 产品价格，保持经营的可持续性。

2025 年，公司继续保持高强度研发投入，全年研发费用约 15.52 亿元，较 2024 年增加 1.99 亿元，近三年累计研发费用 41.87 亿元。多款在研产品取得积极进展：其中，覆盖端侧智能领域和智能汽车领域的新一代高算力 6nm 芯片、Monitor 系列的首款芯片，高算力智能视觉芯片均已流片；集成公司多项 SoC 技术的 Wi-Fi 路由芯片及 Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片，均已成功回片，目前处

于测试阶段。

公司在内生式研发基础上，不断吸纳行业优秀团队与企业。2025年9月，公司宣布收购芯迈微半导体(嘉兴)有限公司（以下简称“芯迈微”），芯迈微团队的加入，将助力公司构筑“蜂窝通信+光通信+Wi-Fi”的多维通信技术栈与产品矩阵，最终形成以“端侧智能+算力+通信”为主干、软硬件一体为支撑，面向多场景，具有独特竞争力的端侧智能解决方案。

面对端侧智能的历史性机遇，公司将继续在端侧智能、高速连接、无线路由、智能视觉、智能显示、智能汽车等重点领域，保持高强度研发投入与市场开拓力度，推动新产品快速高质量上市，推动公司产品向更全的产品矩阵、更广的应用场景、更高性能与品质表现进行扩展，进一步驱动公司业绩增长。

预计2026年第一季度公司营收将实现10%~20%的同比增长，2026年全年公司营收将实现25%~45%的同比增长，具体业绩存在一定不确定性。

（二）主要指标增减变动的主要原因

报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年2月12日